



Underfill FF35 - представляет собой однокомпонентный компаунд с низким поверхностным натяжением, предназначен для использования в качестве заполнителя пространства между корпусом компонента Flip-Chip, CSP, BGA, micro-BGA и поверхностью печатной платы. После нанесения заполнителя в значительной степени повышается надежность установки компонента. Underfill позволяет значительно увеличить прочность фиксации компонента, так как обладает клеящими свойствами. Другой важной особенностью данного материала являются его демпфирующие свойства, благодаря которым установленные компоненты способны выдержать большие вибро- и температурные нагрузки. Однокомпонентный заполнитель FF35 обеспечивает превосходную надежность благодаря высокой температуре стеклования, низкому коэффициенту теплового расширения, хорошему заполнению, отсутствию пустот. При использовании материала FF35 не требуется дополнительное использование флюса. Использование FF35 рекомендуется при проведении ремонтных работ.

Свойства клея UNDERFILL:

- Прекрасный капиллярный эффект для быстрого оплавления.
- Совместимость с безотмывным флюсом.
- Ремонт при 120 °C.
- Не требует специальных условий для хранения.
- Отсутствие пустот при пайке.

По вопросам приобретения клея Underfill FF35 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов